
tde präsentiert beim LANline Tech Forum das tML[®] HD System

05.06.2012, 08:56 | IT, New Media & Software

Pressemitteilung von: *tde - trans data elektronik GmbH*
Presseagentur: *epr-elsaesser public relations*



tde - trans data elektronik als Aussteller beim LANline Tech Forum in Köln am 26./27. Juni Dortmund, 04. Juni 2012. Auf dem LANline Tech Forum in Köln am 26. und 27. Juni präsentiert die tde - trans data elektronik GmbH als führender Hersteller, Distributor und Systemanbieter von Netzwerktechnik und Vorreiter auf dem Gebiet der LWL-Mehrfasertechnologie ihr erfolgreiches modulares Plug & Play Verkabelungssystem tML[®]-tde Modular Link. Als besonderes Highlight zeigt tde erstmals die neue, auf dem LC-Steckgesicht basierende Systemerweiterung tML[®] HD (High Density). Sie umfasst HD Module und HD Stecker mit integriertem Entriegelungsriemen, was die Verdoppelung der Ports und die Nutzung von 192 Fasern auf einer Höheneinheit ermöglicht.

Neuheiten und Trends am Rhein

Im direkt am Rheinufer gelegenen Maritim Hotel Köln präsentieren führende Hersteller und Dienstleister der Branche - darunter auch die tde -trans data elektronik GmbH aus Dortmund - einem interessierten Fachpublikum die aktuellen Trends und Produkte für moderne Rechenzentrums-Umgebungen. "Wir laden alle Besucher, Kunden und Partner herzlich ein, uns am Messestand zu besuchen und ihre individuellen Anforderungen mit unseren Experten vor Ort zu besprechen", so André Engel, Geschäftsführer der tde-trans data elektronik GmbH.

Das tde-Messe-Highlight: tML[®] - tde Modular Link System

tde wird in Köln sein modulares Plug & Play Verkabelungssystem tML[®] - tde Modular Link zeigen und dabei die für künftige Verkabelungsszenarien wegweisende Mehrfasertechnologie in den Mittelpunkt rücken. "Sowohl 40 GbE- wie auch 100 GbE-Netze lassen sich zusammen mit Multimodefasern ausschließlich unter Verwendung von MPO/MTP[®]-Steckern realisieren, die Mehrfasertechnologie ist also die Technologie der nahen Zukunft", erklärt André Engel.

tML[®] ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Es handelt sich dabei um zu 100 Prozent in Deutschland gefertigte, vorkonfektionierte und getestete Systemkomponenten, die vor Ort - insbesondere in Rechenzentren - eine Plug & Play-Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 1/10GbE GbE Performance auf einmal verbunden werden können. Es gibt LWL und TP Module, die zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt eingesetzt werden können.

tML[®] HD - Mehr Ports gehen nicht

Die absolute Neuheit im Rahmen des tML[®]-Systems ist die tML[®] HD Systemerweiterung, ein auf dem LC-Steckertyp basierendes LWL-Verbindungskonzept: Der Stecker des tML[®] HD Patchkabels wird nicht wie gewohnt mit den Fingern aus dem tML[®] Modul entfernt, sondern besitzt einen integrierten Entriegelungsriemen, der den Stecker mit einem Zug aus dem Adapter löst. Dadurch spart tde den Platz, der bisher für das Handling der Stecker einkalkuliert werden musste und kann die Adapter direkt übereinander im tML[®] Modul integrieren. So können auf einer Höheneinheit 192 Fasern verwendet werden - eine Packungsdichte, die branchenweit Ihresgleichen sucht.

Informative Fachvorträge

Neben der Ausstellung des LANline Tech Forums stellen qualifizierte Referenten in Einzelvorträgen aktuelle Lösungen und Trends vor, gewähren Ausblicke auf künftige Entwicklungen und geben nützliche Handlungsempfehlungen.

Tech Forum "Verkabelung - Netze - Infrastruktur"

26./27. Juni 2012

Maritim Hotel Köln, Heumarkt 20, 50667 Köln

Tel: +49 (0) 221 2027 0, Fax: +49 (0) 221 2027 826

S-Bahn: Aufgrund der S-Bahn Bauarbeiten zwischen Neu- und Heumarkt bis Ende 2012 empfehlen wir die Anfahrt über die Rheinuferstraße (Am Leystapel).

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

<http://www.lanline.de/events/tech->

[forum-%E2%80%9Everkabelung-%E2%80%93-netze-%E2%80%93-infrastruktur%E2%80%9D.html-0](http://www.lanline.de/events/tech-forum-%E2%80%9Everkabelung-%E2%80%93-netze-%E2%80%93-infrastruktur%E2%80%9D.html-0)

Bild (c) Lanline

Portrait

Als international erfolgreich agierendes Unternehmen im Bereich Daten- und Kommunikationstechnik ist die tde - trans data elektronik GmbH auf die Herstellung und Distribution von Netzwerkkomponenten spezialisiert und gilt als technologischer Vorreiter im Bereich der optischen Mehrfasertechnologie. Mit einer äußerst hochwertigen Produktpalette an Kupfer- und Glasfaserapplikationen inklusive der Verteilertechnik bietet der erfahrene Netzwerkexperte Komplettlösungen in den Anwendungsfeldern Datacom, Telecom, Industry und Defence. Zudem bietet die tde als Systemanbieter auch die komplette Planung und Installation von Netzwerken aus einer Hand. Als einer der wenigen deutschen Hersteller von Netzwerkkomponenten unterstützt tde den Code of Conduct für Energieeffizienz in Rechenzentren, eine Initiative der Europäischen Kommission. Weitere Informationen unter: www.tde.de

News-ID: 637778 • Views: 757 (Stand: 25.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/637778/tde-praesentiert-beim-LANline-Tech-Forum-das-tML-HD-System.html>